

ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI Intel H770 LGA 1700 ATX

ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI. Fabricant de processeur: Intel, Socket de processeur (réceptacle de processeur): LGA 1700, Processeurs compatibles: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Types de mémoire pris en charge: DDR5-SDRAM, Mémoire interne maximale: 128 Go, Type de support (slot): DIMM. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2, SATA III, Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD, Niveaux RAID: 0, 1, 5, 10. Type d'interface Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standards wifi:

EAN : 4711387008249

Réf. : 90MB1D50-M0EAY0

Types de mémoire pris en charge: DDR5-SDRAM

Élément de forme de carte mère: ATX

Mémoire interne maximale: 128 Go

Carte mère chipset: Intel H770

Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2, SA.

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte mère Asus**, dont la référence est **90MB1D50-M0EAY0**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1700
Nombre max. de processeurs SMP	1
Processeurs compatibles	Intel Celeron , Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium Gold
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1700
Fabricant de processeur	Intel

Mémoire

Mémoire sans tampon	Oui
Mémoire interne maximale	128 Go
Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max)	7200 MHz
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000, 5800, 5600,5400,5200,5000,4800 MHz
Non-ECC	Oui
Canaux de mémoire	Double canal
Type de support (slot)	DIMM
Nombre de logements pour mémoire	4
Types de mémoire pris en charge	DDR5-SDRAM
ECC compatibility	Non-ECC

Contrôleur de stockage

Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Support RAID	Oui
Nombre de disque dur supporté	4
Nombre d'unités de stockage pris en charge	8
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, SATA III
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD

Graphique

Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge
--	--------------------

I/O interne

Connecteur au LED RGB	Oui
Embases Thunderbolt	1

Nombre de connecteurs COM	1
Connecteur d'alimentation 12 V	Oui
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	1
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	4
Connecteur CPU FAN	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur de panneau avant	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Nombre de connecteurs SATA III	4
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connecteurs USB 2.0	2

Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)

Jack antenne WIFI-AP	2
Port de sortie S/PDIF	Oui
Entrée jack microphone	Oui
Sortie de casque	1
Entrée ligne	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.1
Quantité de ports HDMI	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4

Réseau

Modèle du Bluetooth	5.2
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet

Ethernet/LAN	Oui
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui

Caractéristiques

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
famille de composant de produits	Intel
Type de refroidissement	Passif
Type de source d'alimentation	ATX
Élément de forme de carte mère	ATX
composant pour	PC
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Carte mère chipset	Intel H770

Connecteurs d'extension

Nombre d'emplacements M.2 (M)	4
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x)	1
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)	1
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x)	2

BIOS

Capacité de mémoire du BIOS	192 Mbit
Type de BIOS	UEFI AMI

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,98 kg
Hauteur du colis	270 mm
Profondeur du colis	75 mm
Largeur du colis	340 mm

Poids et dimensions

Profondeur	244 mm
Largeur	305 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	SATA
Guide d'utilisation	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)